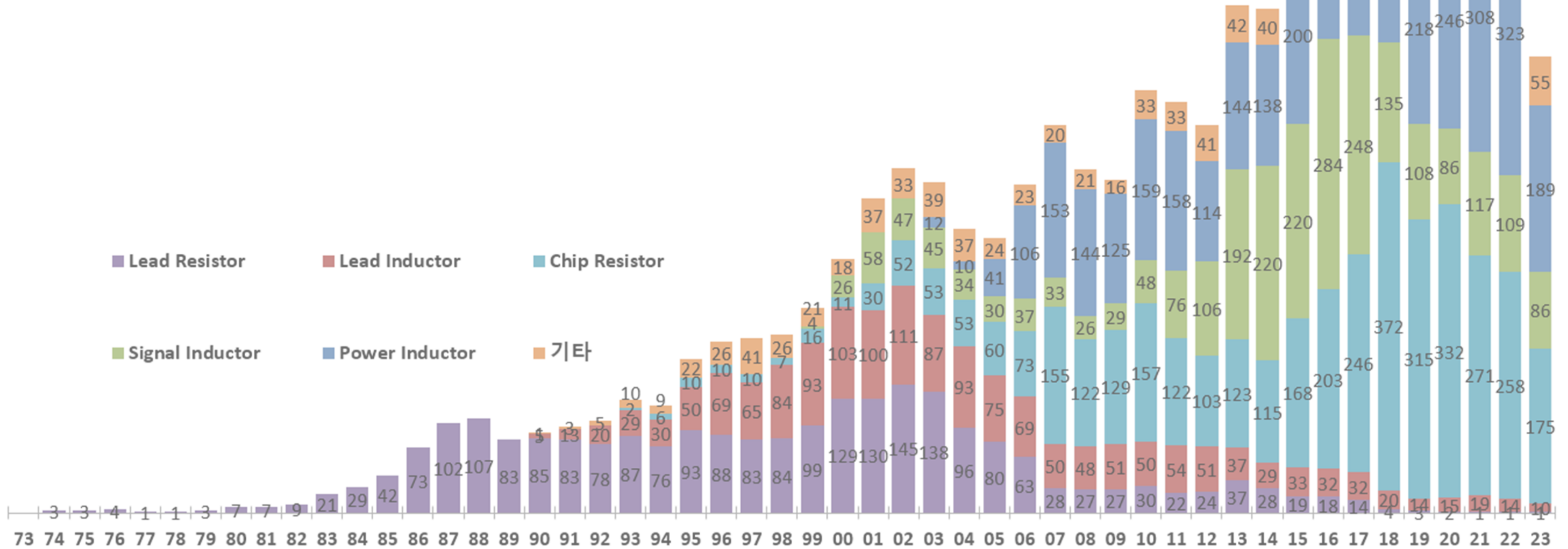




아비코전자



상기 내용은 아비코전자(주)의 별도기준으로 작성하였습니다. (단위 : 억원)

본 자료는 아비코전자 주식회사(이하 “회사”)에 의해 작성되었으며,
회사는 본 자료의 정확성과 완벽성에 대해 보장하지 않으며,
자료 작성일 현재의 사실을 기술할 내용에 대해 향후 갱신 관련 책임을 지지 않습니다.

또한, 본 자료는 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있습니다.

이러한 예측 정보는 이미 알려진 또는 아직 알려지지 않은 위험과 시장 상황,
기타 불명확한 사정 또는 당초 예상하였던 사정의 변경에 따라 영향을 받을 수 있고,
이에 기재되거나 암시된 내용과 실제 결과 사이에는 중대한 차이가 있을 수 있으며,
시장 환경의 변화와 전략 수정 등에 따라 예고 없이 달라질 수 있습니다.

이 자료는 투자자 여러분의 투자 판단을 위한 참고자료로 작성된 것으로,
당사 및 당사의 임직원들은 이 자료의 내용과 관련하여
투자자 여러분에게 어떠한 보증도 제공하지 아니하며,
과실 및 기타의 경우를 포함하여 투자결과에 대한 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려 드립니다.

아비코전자(주) - Inductor, Resistor 전문생산기업

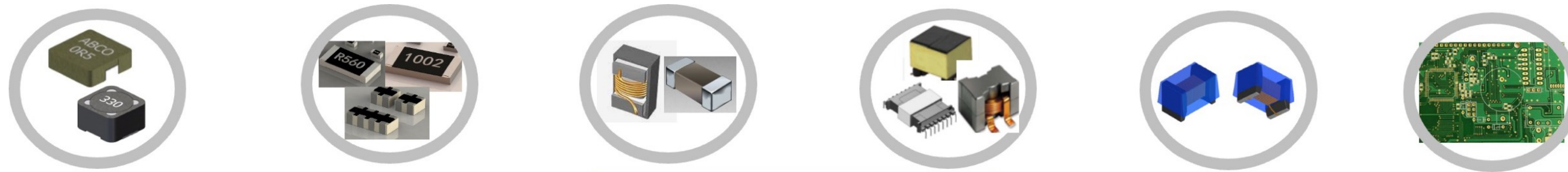
1973년 설립, 지난 52년간 저항기(Resistor) 및 인덕터(Inductor) 전문 생산

R	= Resistor	전기의 흐름을 억제하여 전류와 전압을 조정
L	= Coil & Transformer	무선통신회로와 전원공급 회로상에 전기흐름과 신호를 안정
C	= Capacitor	안정적인 전원공급을 위해 에너지를 저장, 직류 전류를 차단하고 신호를 분리

- 저항기, 인덕터는 수동전자부품으로 스마트폰을 포함하여 최근 각광받고 있는 태블릿, PC, 스마트TV, 백색가전, IoT 관련 디지털 IT 제품등에 광범위하게 사용

아비코테크(주) - 인쇄회로기판(PCB) 전문생산기업, 자회사(지분 100%)

- 1985년 설립, 지난 39년간 인쇄회로기판(PCB) 전문 생산
- 절연기판 위에 전기적 신호를 전달할 수 있는 도체를 형성시킨 것으로 전자부품 탑재 시 전기회로를 구성하여 작동
- 인체의 신경으로 비유되는 PCB는 소형 가전제품에서부터 첨단 이동 통신기기에 이르기까지 모든 전자기기에 사용되는 핵심부품



수동소자 & PCB



Semiconductor



Smartphone



Automotive

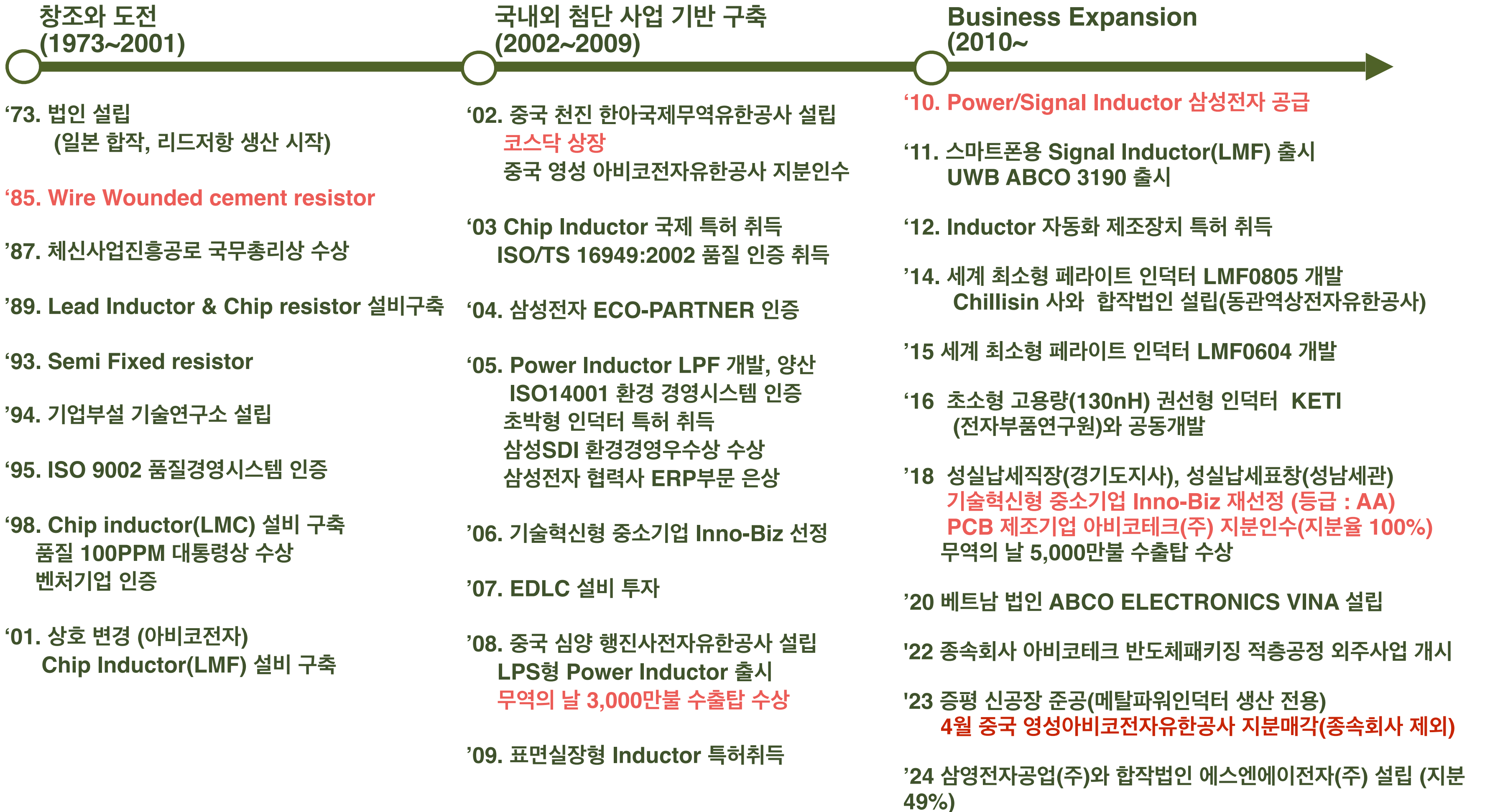


Display/TV



Home appliances

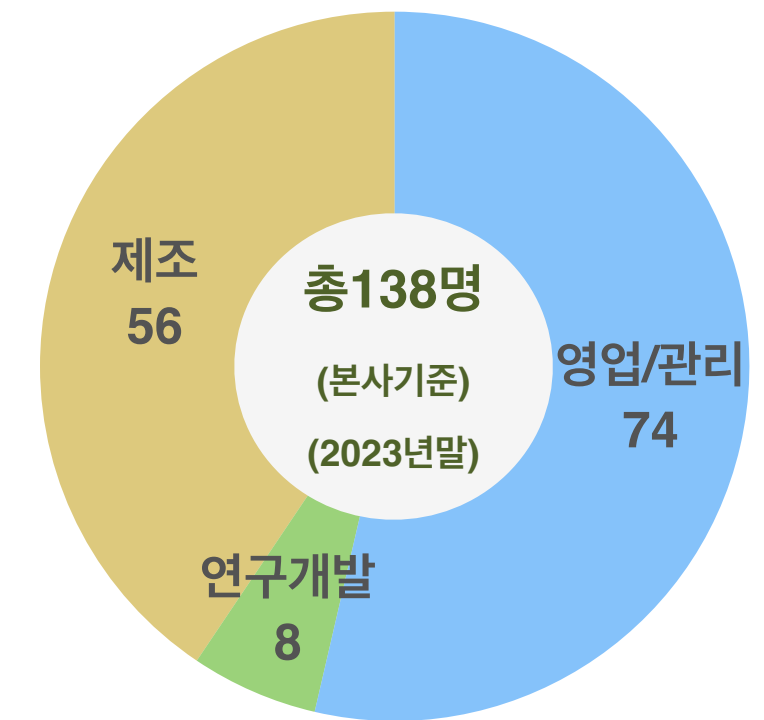
아비코전자(주) History



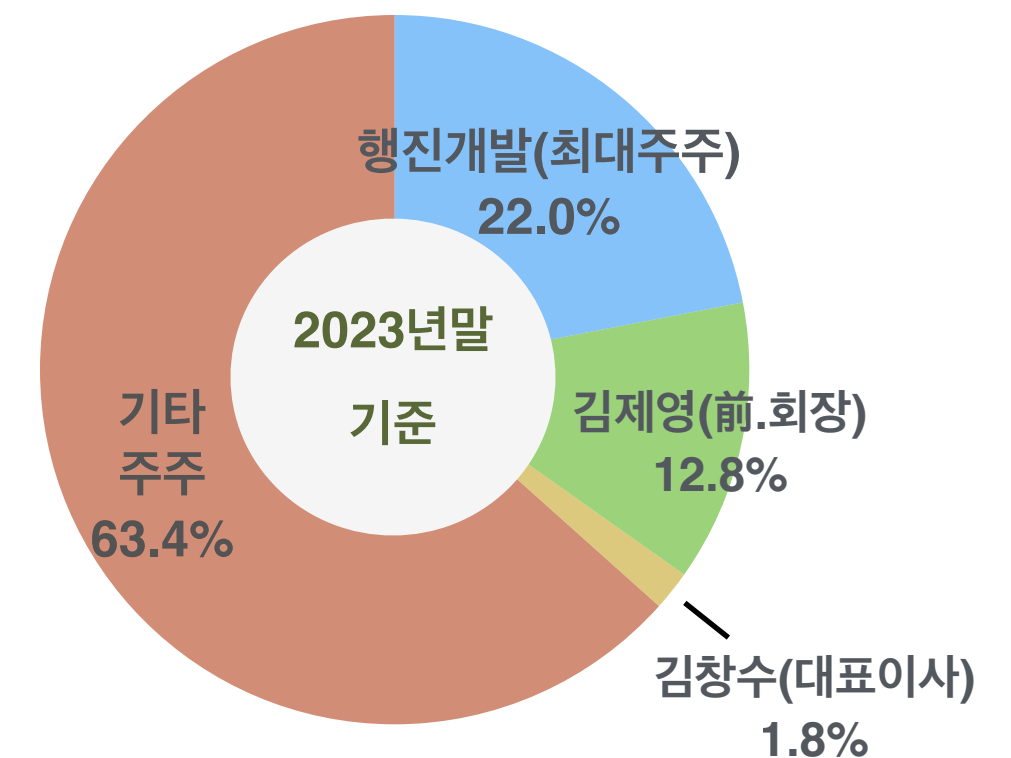
개요 및 인력, 주주현황

주요사업	전자부품 제조	
등기임원	(대표이사) 김창수 (사내이사) 김완중, 박지현	(사외이사) 김필영 (감사) 금지현
본사	경기도 성남시 둔촌대로 388번길 31 (상대원동)	
총발행주식수	13,292,934주	
자본금	69억원	
연결종속회사	수동소자	아비코전자(주) : 지배회사 아비코전자비나(유) : 베트남, 지분 100% *2023.04.12 영성아비코전자유한공사 지분매각 → 2023년 2분기부터 종속회사 제외
	PCB	아비코테크(주) : 지분 100%

인력 현황



주주 현황

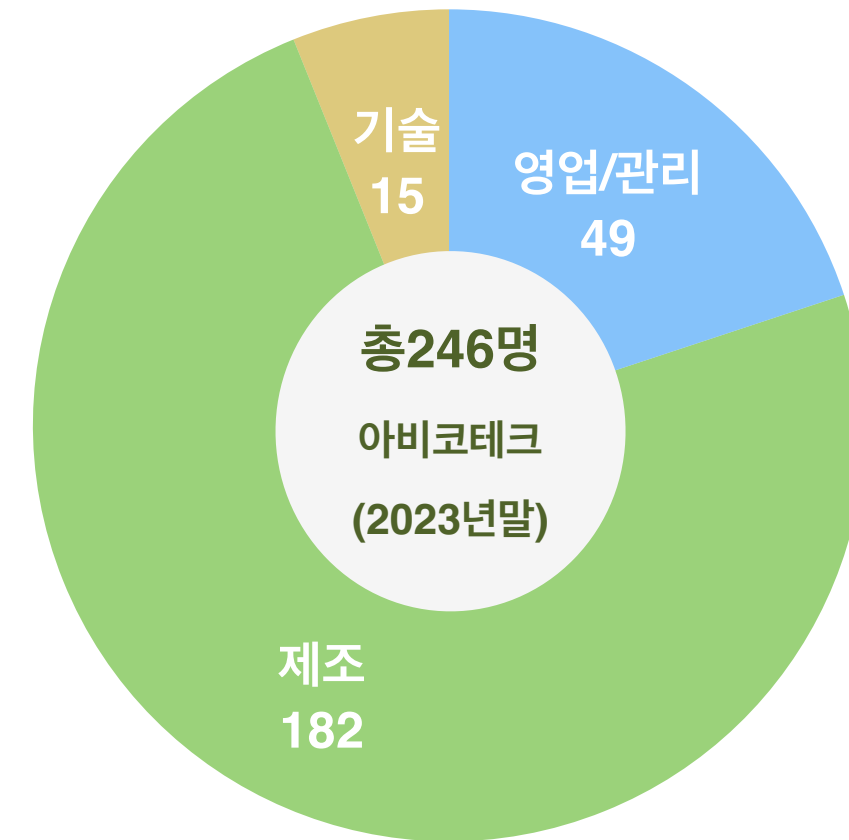


개요 및 인력, 주주현황

- 2018년 9월 지분 100% 인수함에 따라 **PCB 사업 진출**

주요사업	PCB 제조
등기임원	(각자대표이사) 김창수, 이요한 (사내이사) 박지현 (감사) 구자환
본사	충청북도 증평군 증평읍 내룡로 36번길
총발행주식수	48,000,000주 - 아비코전자 지분100%
생산설비 및 생산품	<p>▶ 생산설비 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1공장 : 대지면적(36,501㎡), 건물면적(18,213㎡) - 2공장 : 건물 면적(14,884㎡) <p>▶ 생 산 품 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rigid PCB : D/S, MLB (4L~12L) - Build-up PCB (4L~12L) - 반도체패키징PCB 적층공정
자본금	<p>240억원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2021.5.28 유상증자 100억원, 2021.10.28 유상증자 70억원 * 반도체패키징기판 적층공정 생산시설 투자 목적으로 유상증자 * 2022년 1월부터 반도체패키징 적층공정 임가공 매출 본격화

인력 현황



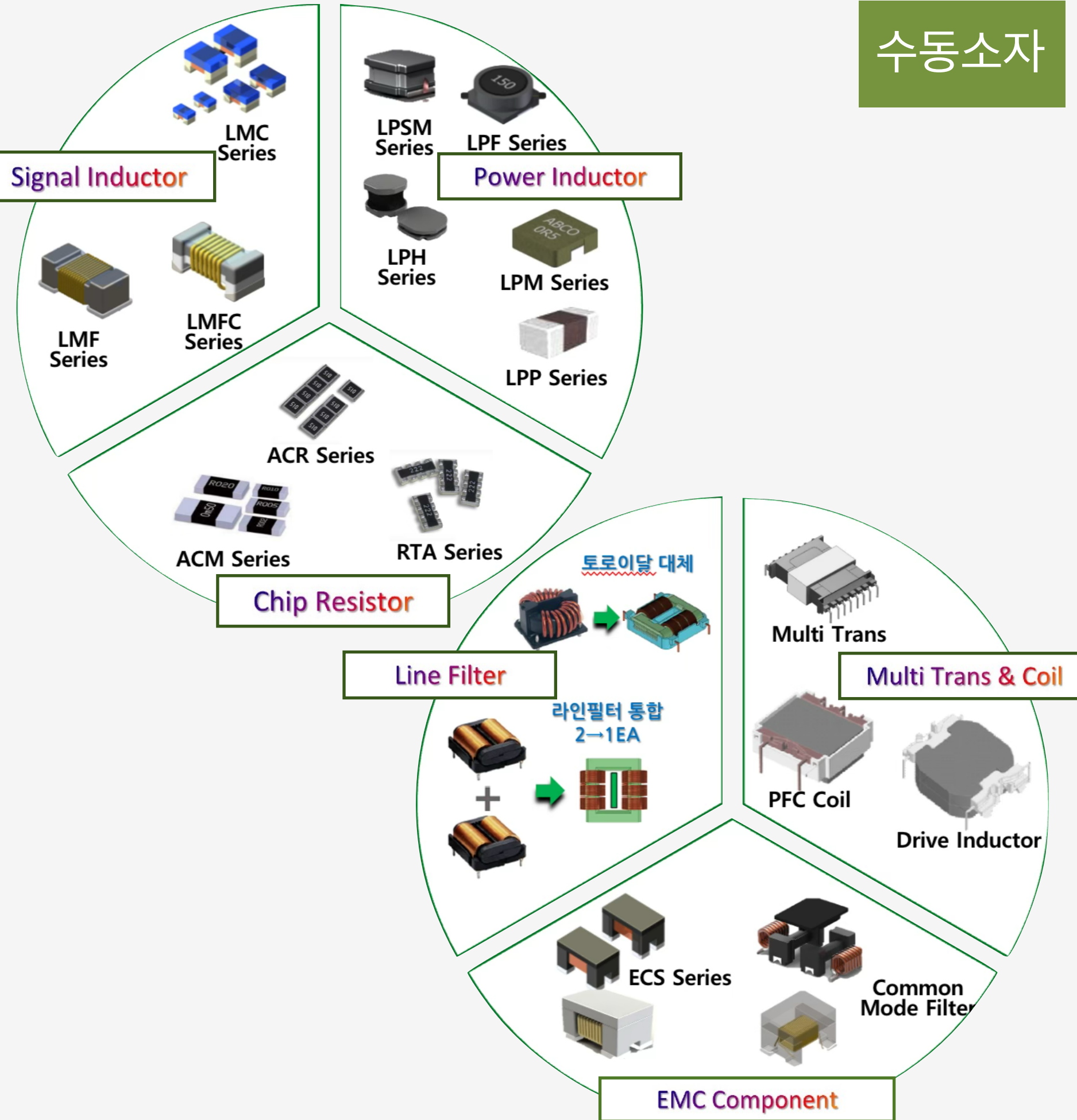
아비코테크(주) 요약재무정보

구분 (단위:백만원)	24년 9월말	23년말	22년말	21년말	20년말	19년말	18년말	17년말
자산총계	50,781	51,626	47,958	47,384	29,883	30,305	35,299	40,911
부채총계	34,657	33,088	26,022	28,057	26,511	19,267	15,431	94,749
자본총계	16,124	18,538	21,936	19,327	3,373	11,038	19,869	-53,838
매출액	50,546	73,723	90,481	73,579	50,005	50,045	63,089	82,625
MLB	41,971	64,247	78,062	71,417	50,005	50,045	63,089	82,625
임가공	8,574	9,476	12,420	2,162	-	-	-	-
영업이익	-1,850	-2,290	3,019	-2,022	-7,458	-8,879	-6,936	-9,121
당기순이익	-2,414	-3,597	1,415	-2,608	-9,086	-9,018	-7,734	-15,545

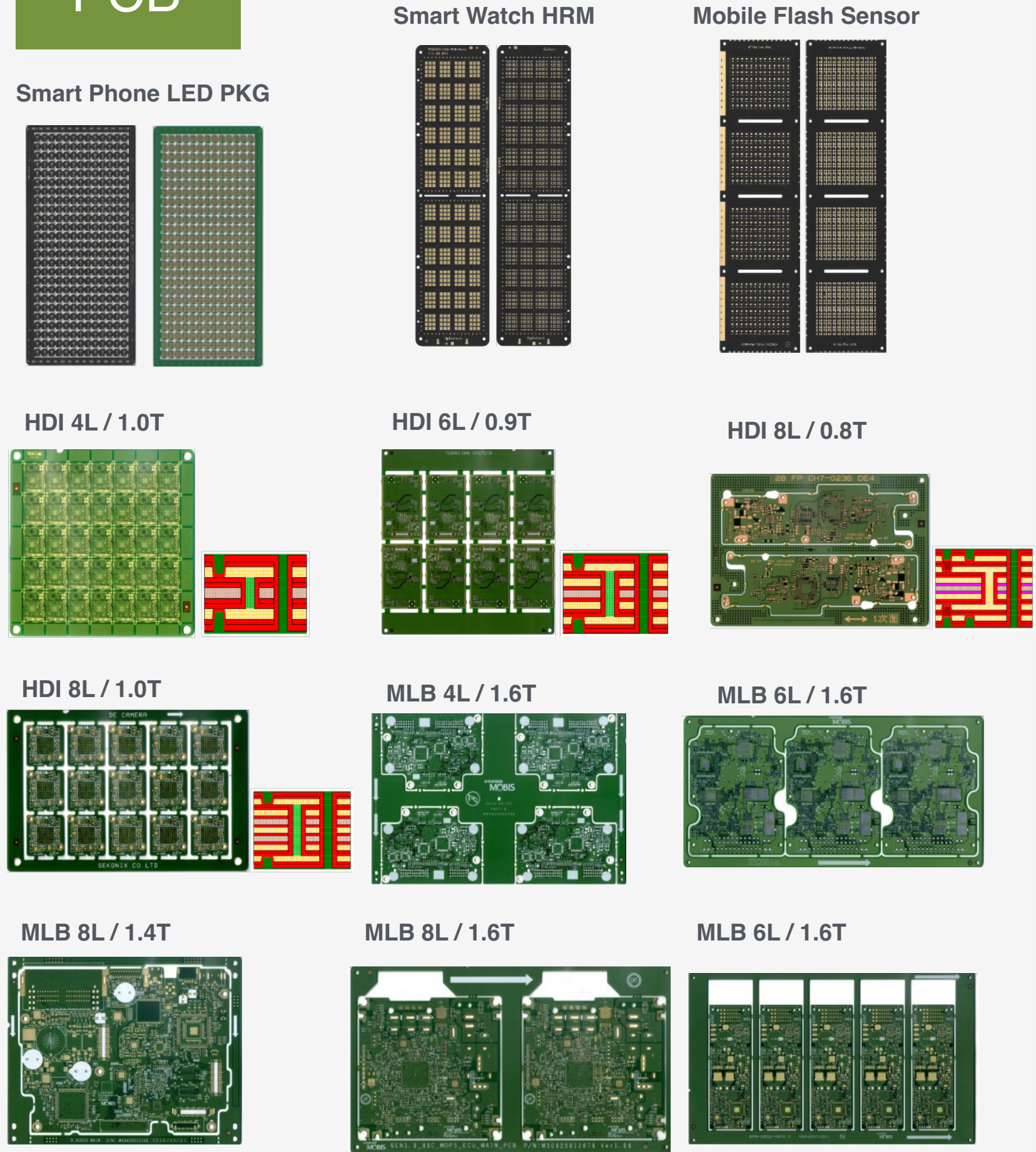
(*) IFRS 기준

주요 Line-up

수동소자



PCB



Application

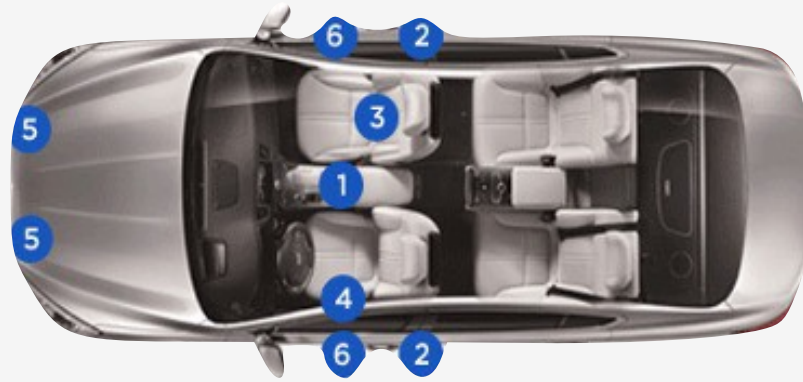
수동소자 & PCB : IT / 반도체 / 가전 제품

- 스마트폰, 스마트워치
- Micro-processor, Memory
- 5G통신장비
- 디지털카메라, 전자담배
- 냉장고, 세탁기, TV
- 컴퓨터, 복합기, 프린터, 유무선 전화기
- 의료기기(혈압계, 체지방측정기, 심장박동측정기, AED자동세정기)
- 산업용기기(철도 부품, 산업용 엘리베이터)



PCB 자동차 전장부품

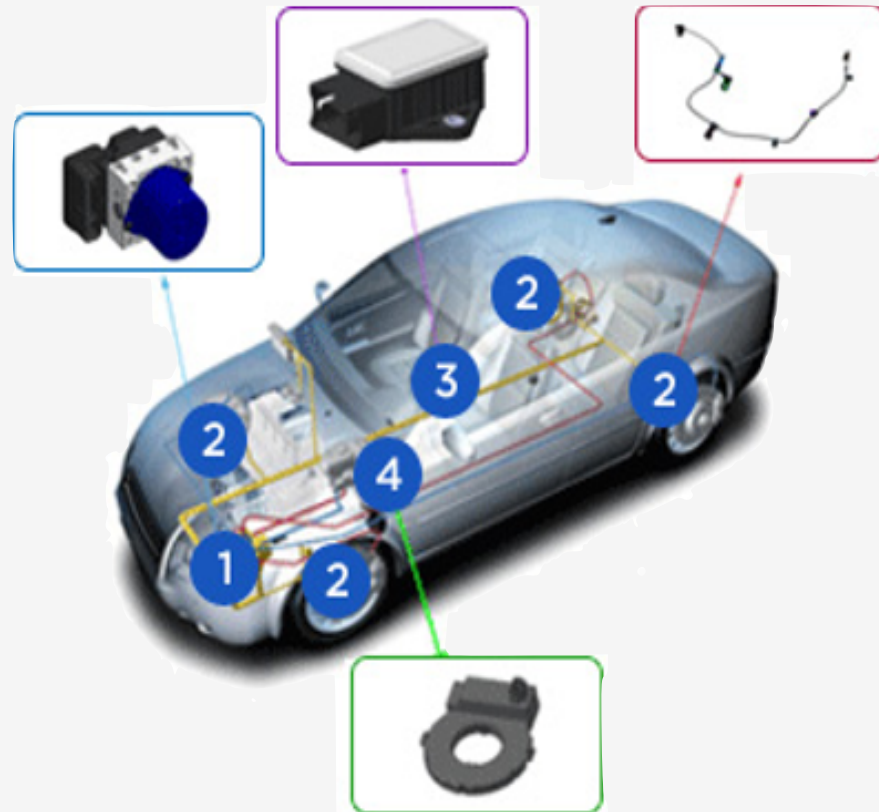
안전시스템



- 1 에어백 제어 장치 (ACU, Airbag electronic Control Unit)
- 2 측면 충돌 감지 센서 가속도계 타입 (SIS, Side Impact Sensor)
- 3 승객식별 시스템 (OCS, Occupant Classification System)
- 4 시트 위치 감지 센서 (STPS, Seat Track Position Sensor)
- 5 정면 충돌 감지 센서 가속도계 타입(FIS, Front Impact Sensor)
- 6 측면 충돌 감지 센서 압력 타입(PSSIS, Pressure Side Impact Sensor)



- 7 시트 벨트 프리텐셔너 (SBPT, Seat Belt with PreTensioner)
- 8 운전석 에어백 (DAB, Driver AirBag module)
- 9 조수석 에어백 (PAB, Passenger AirBag module)
- 10 측면 에어백 (SAB, Side AirBag module)
- 11 커튼 에어백 (CAB, Curtain AirBag module)
- 12 무릎 에어백 (KAB, Knee AirBag module)



제동시스템

- 1 ABS-ECU
- 2 Wheel Speed Sensor
- 3 ABS G-Sensor
- 4 Steering Angel Sensor

조향시스템



MDPS(Motor Driven Power Steering)

- Column-Type MDPS
- Dual-Pinion Rack-Type MDPS
- Belt Rack-Type MDPS

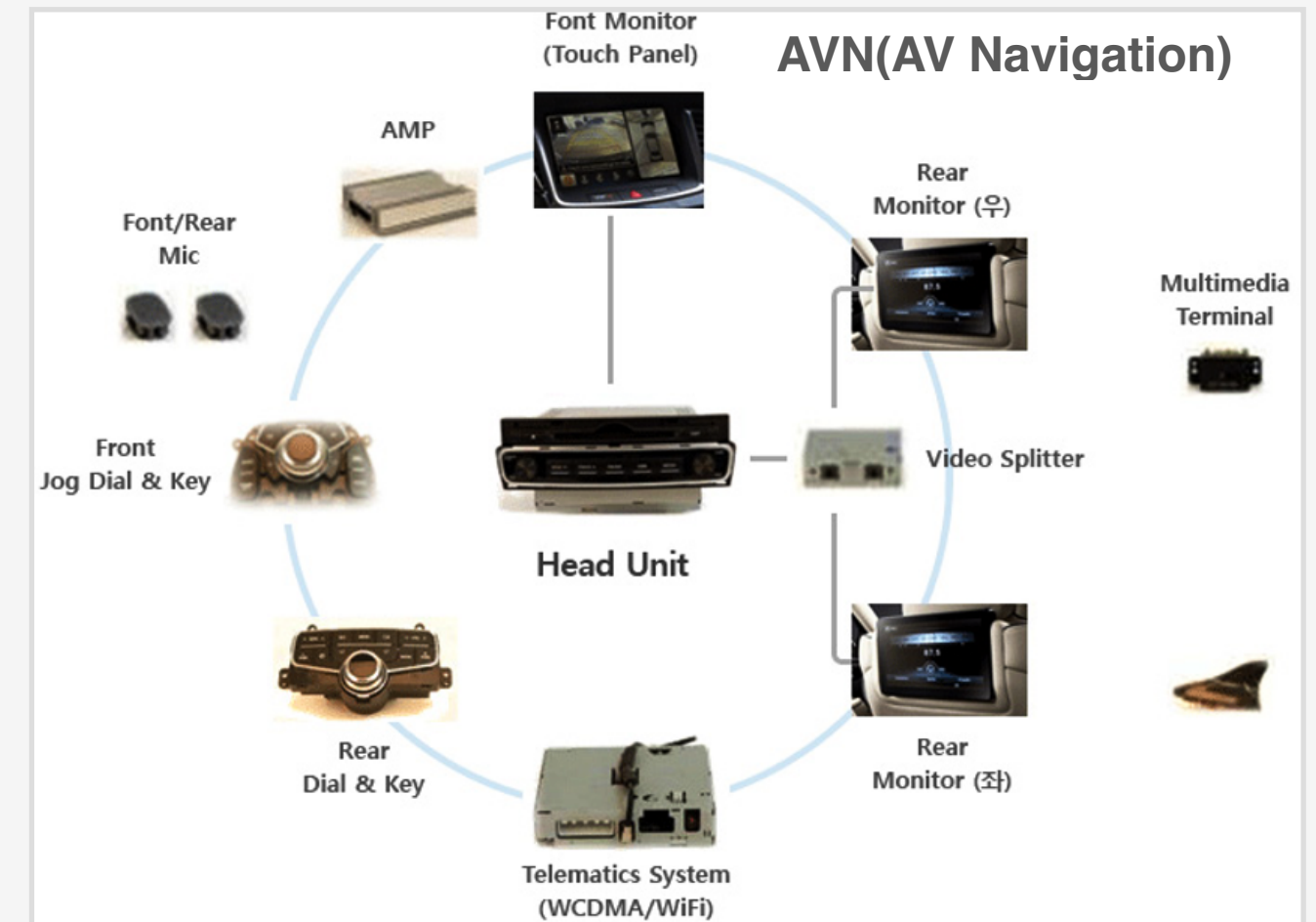
전기차 배터리 충전시스템



커넥티드 카



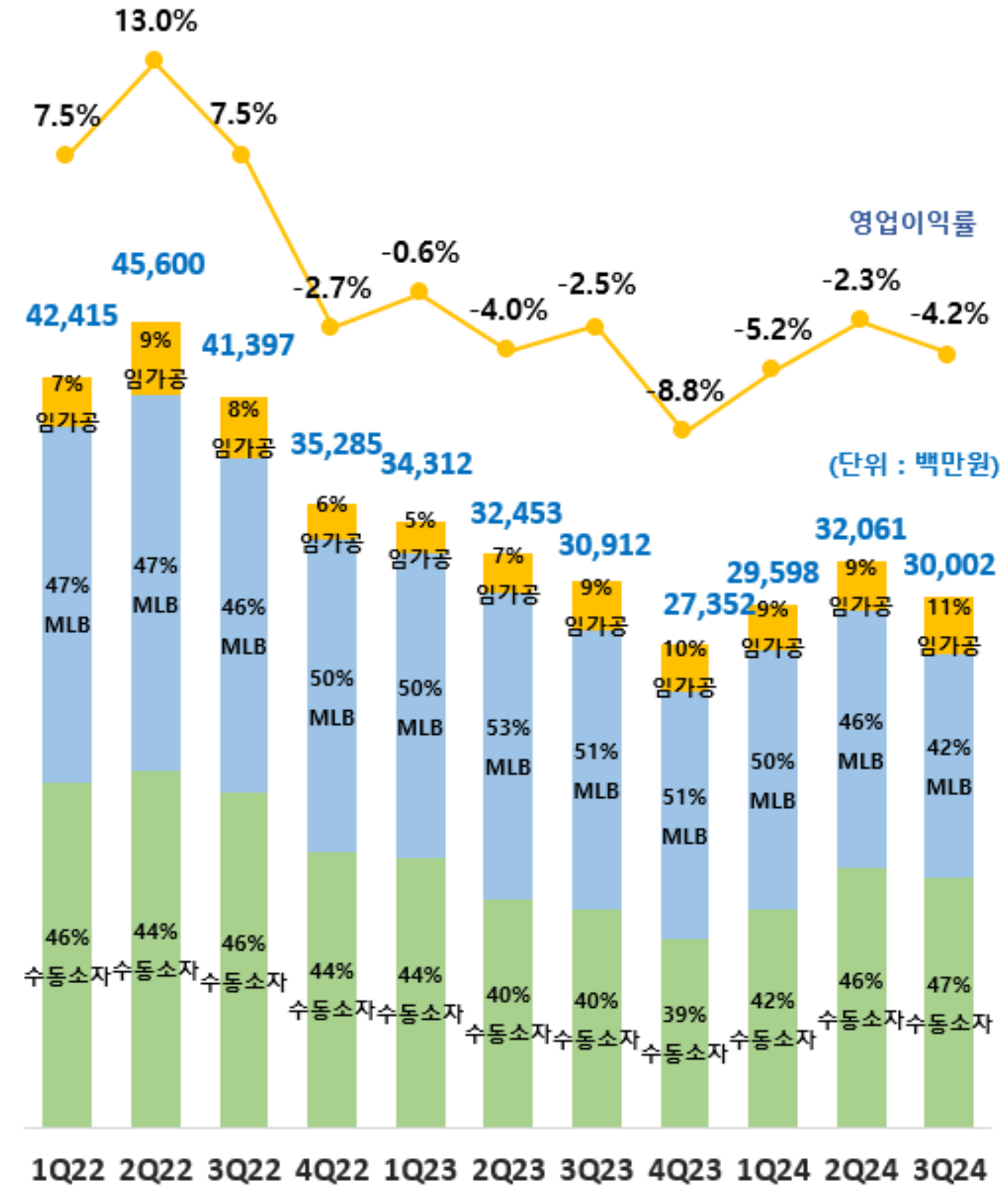
AVN(AV Navigation)



분기별 매출추이 (연결기준)

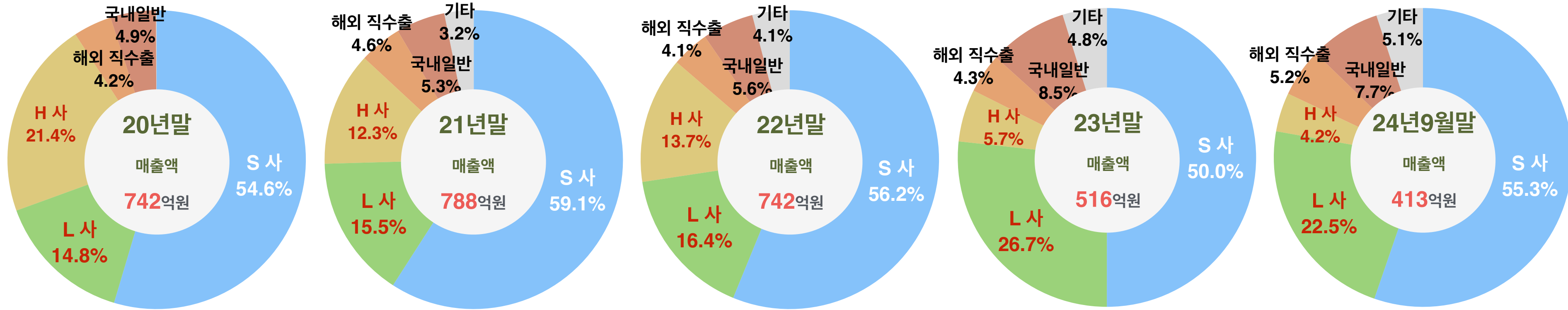
연결기준 (단위: 백만원)	22년				23년				24년			증감율 (QoQ)	증감율 (YoY)
	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24		
매출액	42,415	45,600	41,397	35,285	34,312	32,453	30,912	27,352	29,598	32,061	30,002	-6.4%	-2.9%
수동소자	19,570	20,156	18,910	15,579	15,268	12,956	12,374	10,709	12,325	14,657	14,133	-3.6%	14.2%
PCB	22,845	25,444	22,486	19,706	19,044	19,497	18,538	16,644	17,272	17,404	15,869	-8.8%	-14.4%
MLB	20,084	21,288	18,985	17,704	17,178	17,287	15,775	14,007	14,686	14,620	12,665	-13.4%	-19.7%
임가공	2,761	4,155	3,501	2,003	1,866	2,210	2,763	2,636	2,587	2,784	3,203	15.1%	15.9%
매출액 비중													
수동소자	46%	44%	46%	44%	44%	40%	40%	39%	42%	46%	47%	1.4%p	7.1%p
PCB	54%	56%	54%	56%	56%	60%	60%	61%	58%	54%	53%	-1.4%p	-7.1%p
MLB	47%	47%	46%	50%	50%	53%	51%	51%	50%	46%	42%	-3.4%p	-8.8%p
임가공	7%	9%	8%	6%	5%	7%	9%	10%	9%	9%	11%	2.0%p	1.7%p
매출총이익	6,147	9,052	6,353	3,261	3,274	2,171	2,257	1,019	1,586	2,503	2,027	-19.0%	-10.2%
매출총이익률	14.5%	19.9%	15.3%	9.2%	9.5%	6.7%	7.3%	3.7%	5.4%	7.8%	6.8%	-1.1%p	-0.5%p
영업이익	3,178	5,944	3,114	(944)	(211)	(1,301)	(786)	(2,414)	(1,545)	(734)	(1,259)	-71.7%	-60.3%
수동소자	2,431	4,176	1,663	1	265	(636)	(403)	(1,647)	(1,112)	(2)	(573)	-23402.6%	-42.0%
PCB	747	1,767	1,450	(945)	(476)	(665)	(382)	(767)	(433)	(731)	(686)	6.1%	-79.6%
영업이익률	7.5%	13.0%	7.5%	-2.7%	-0.6%	-4.0%	-2.5%	-8.8%	-5.2%	-2.3%	-4.2%	-1.9%p	-1.7%p
법인세차감전순이익	4,051	4,900	3,258	(833)	285	(2,626)	(201)	(1,803)	(344)	203	(216)	적자전환	-7.8%
당기순이익	3,276	4,074	2,748	(739)	187	(2,454)	1,382	(1,488)	(346)	(188)	(474)	-151.6%	적자전환
순이익률	7.7%	8.9%	6.6%	-2.1%	0.5%	-7.6%	4.5%	-5.4%	-1.2%	-0.6%	-1.6%	-1.0%p	-6.1%p

(*) PCB는 아비코테크, 수동소자는 아비코전자, VINA, WH로 연결에서 아비코테크(PCB) 제외한 숫자임.

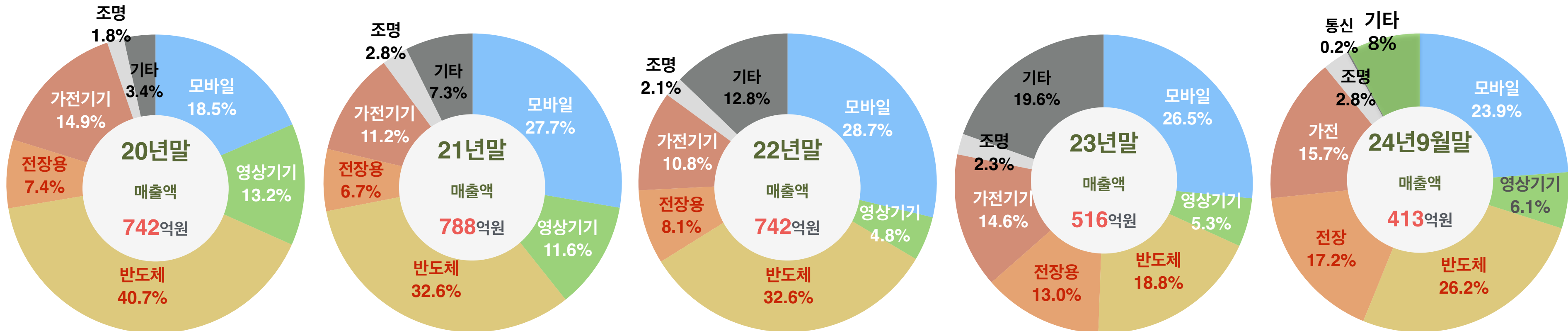


아비코전자(수동소자) 매출 비중 (별도기준)

고객사별 변화추이



Application Set 변화추이



시장 성장 확대

- 인터넷을 기반으로 모든 사물을 연결하여 사람과 사물, 사물과 사물 간의 정보를 상호 소통하는 지능형 기술 및 서비스
- Wi-Fi, NFC, Blue-Tooth, RFID, 전장용 등의 다양한 통신방식으로 연결
- 시그널인덕터 및 파워인덕터는 최근 IT제품들의 초소형화, 다기능화, 고전력화, 디지털화, 고주파화 등의 영향으로 수요 확대 中



시그널인덕터(Signal Inductor)

- 전자 방사수준이 높은 신호라인에서 발생하는 Noise를 신호 주파수로부터 분리, 제거
- 최근 IT기기들의 디지털화, 고주파화에 따른 Noise 증대

파워인덕터(Power Inductor)

- 최근 IT기기들의 다기능화, 고전력화에 따른 안정적인 전류/전압 유지

EMI/EMC 관련 필요성 증대

- 소형화 및 기기간 간섭증가
- 근거리 통신 및 전파규제 강화

Signal Inductor - LMF, LMC (권선형 Type)

스마트폰 RF, Receiver, Speaker, NFC 적용

Noise 제거 부품 수요 증가

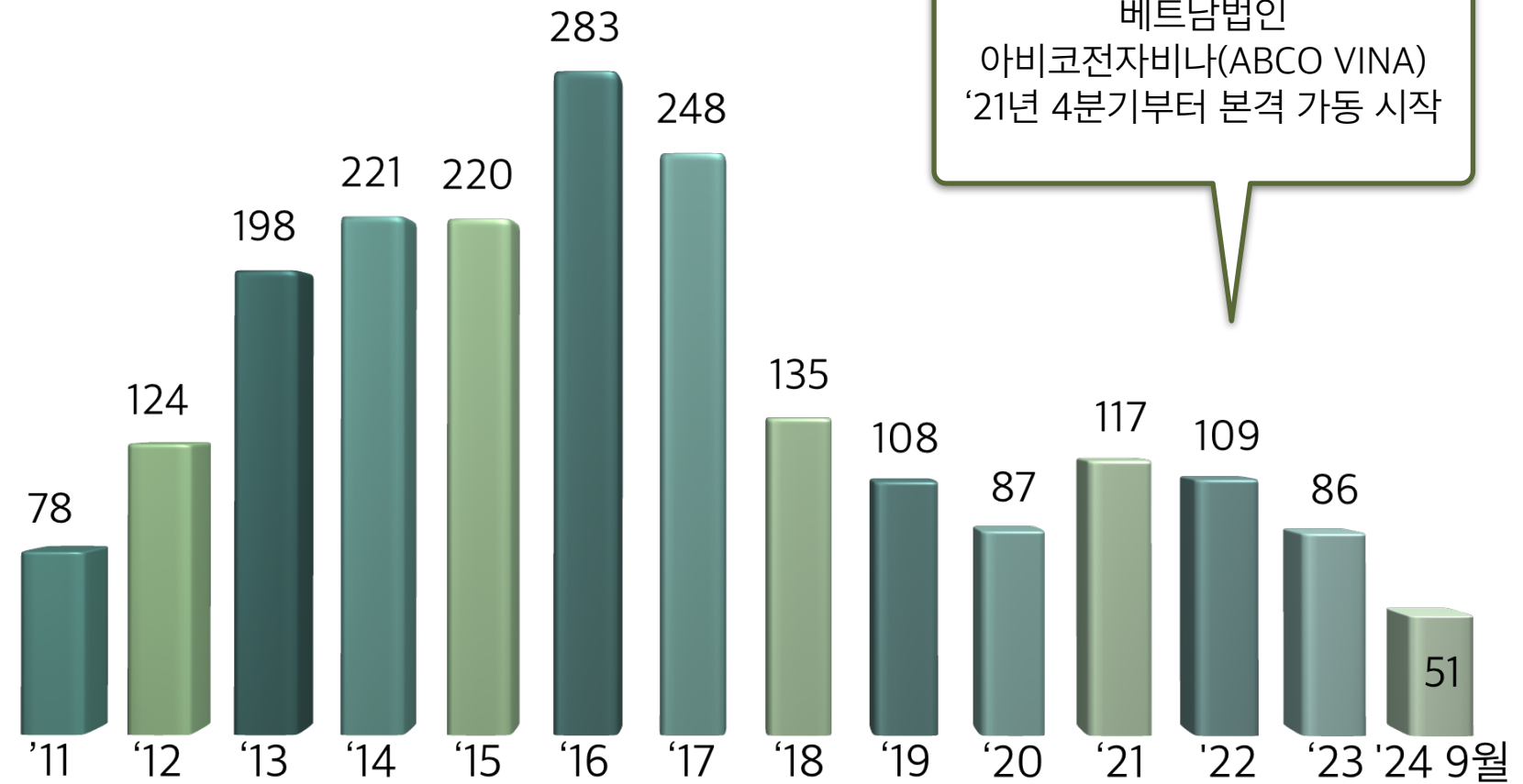
- 기존 일본 무라타 등의 해외부품사에 의존하던 부품으로 국산화 성공
- 아비코전자 비나(베트남법인)을 통한 원가 경쟁력 확보 ▶ 고객사 내 MS 확대
- 최근 전자기기의 디지털화, 다기능화, 고주파화, 고전력화 등으로 전자방해요인 증가요인 증가에 따른 전기적 Noise 문제 심화
- 기존 플래그십 위주의 스마트폰에 적용, 16년 중저가 모델로 확대 적용
- 경박단소화 요구에 따른 소형화 개발

Line up : 2012 → 1608 → 1005 → 0805 → 0604 → 0603 → 0402 (mm)

NFC용 Signal Inductor 개발 및 공급 개시

- 근거리 통신(NFC) 효율 향상용 권선형 Ferrite Inductor line-up
- NFC(삼성페이 등) 시장 확대 성장에 따라 중저가모델에도 확대 적용

시그널인덕터 매출 추이 (단위: 억원)



베트남법인
아비코전자비나(ABCO VINA)
'21년 4분기부터 본격 가동 시작



Power Inductor - (페라이트 타입)LPF, LPS, LPSR, LPH, LPB & (메탈타입) LPP, LPM, LPSM, LPHM

TV, 백색가전, 전장기기에서 스마트폰, 자동차 전장, 반도체등 확대 적용 중

※ 고부가가치 제품 매출처 확대에 따른 Product Mix. 안정적 제품 Line-up

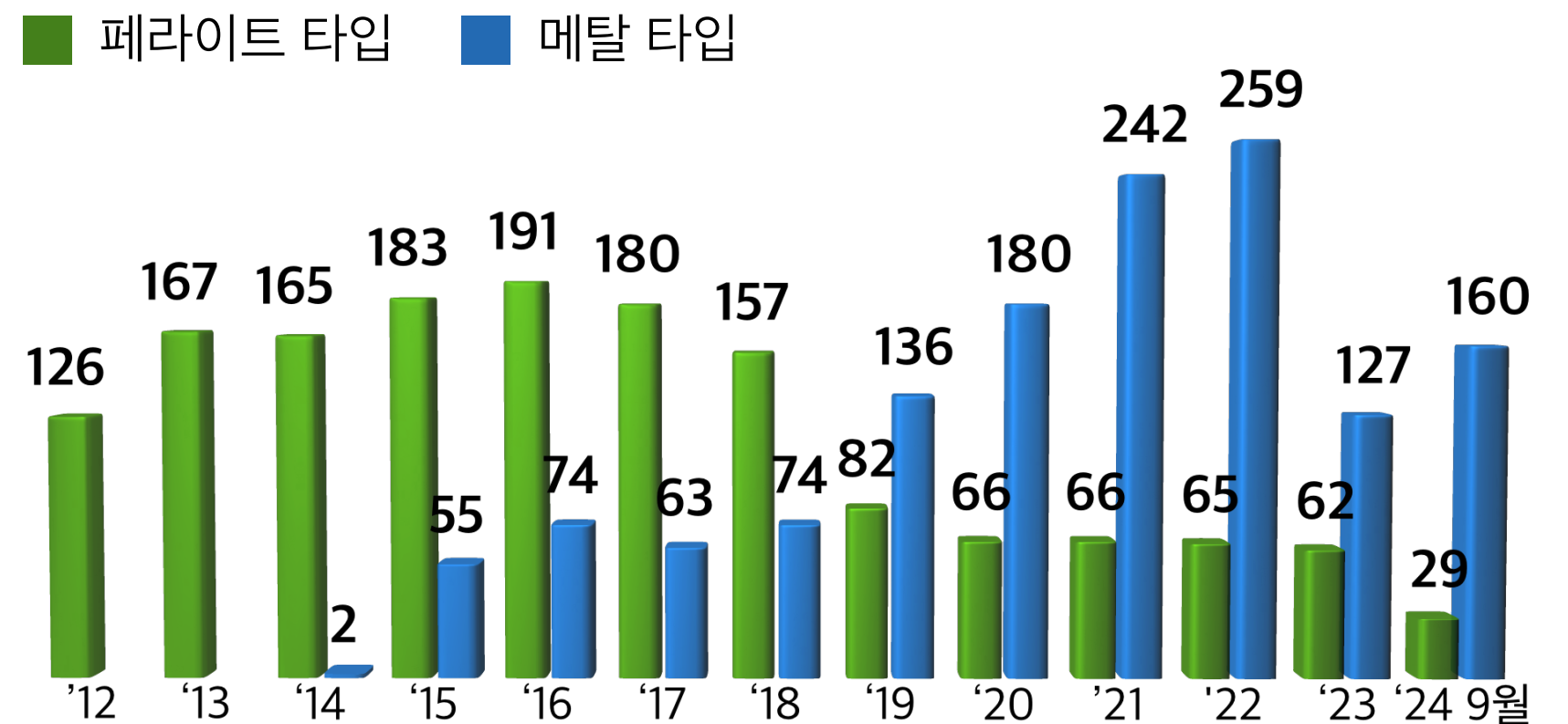
페라이트 타입 자동화 생산라인에 따른 경쟁력 확보

- Line-up : LPF, LPS, LPSR, LPB, LPSM, LPH-ER
- TV Module용 고효율 Ferrite Shield 권선형 INDUCTOR
- LPH-ER Series 양산화
- 자동화 생산라인 가동에 따른 생산 효율 증가 및 원가절감에 따른 경쟁력 확보
- 적용 분야
 - LCD, LED, UHD, OLED TV
 - 차량용 Telematics(Navigation, Audio, Display)
 - LED 조명등 시장 성장
 - 백색가전, 기타 등등

메탈 타입 인덕터 국산화 성공 및 시장확대

- line-up : Metal Alloy Type : LPP, LPM
Metal Core Type : LPSM, LPHM
- Metal Power Inductor는 기존 파워인덕터와 달리 코어가 없이 빈 공간에 코일을 감아 초소형화된 특화된 INDUCTOR, 배터리로부터 오는 전력을 안정화하여 반도체, IC등에 공급하는 핵심 소자 부품
- 최근 스마트폰, 웨어러블기기, 전기자동차 등에 5G통신, 멀티카메라 같은 부품의 수가 늘어남에 따라 공간이 부족하고 전력량이 증가하여 초소형화된 크기와 고전력을 견딜 수 있는 Metal Power Inductor가 요구되고 있는 추세
- 기존 TOKO, Taiyo Yuden 등 일본 부품사가 선점하던 부품으로 국산화 성공, 2014년부터 고객사에 공급 개시
- 현재 고객사내 스마트폰, 반도체(SSD), 전기자동차등에 공급 중

파워인덕터 매출 추이 (단위: 억원)



파워 인덕터 변화 : 페라이트타입 ▶ 메탈타입



Chip Resistor 시장 성장 확대

D-RAM 아키텍처 변화 및 SSD 수요증가에 따른 매출 증가

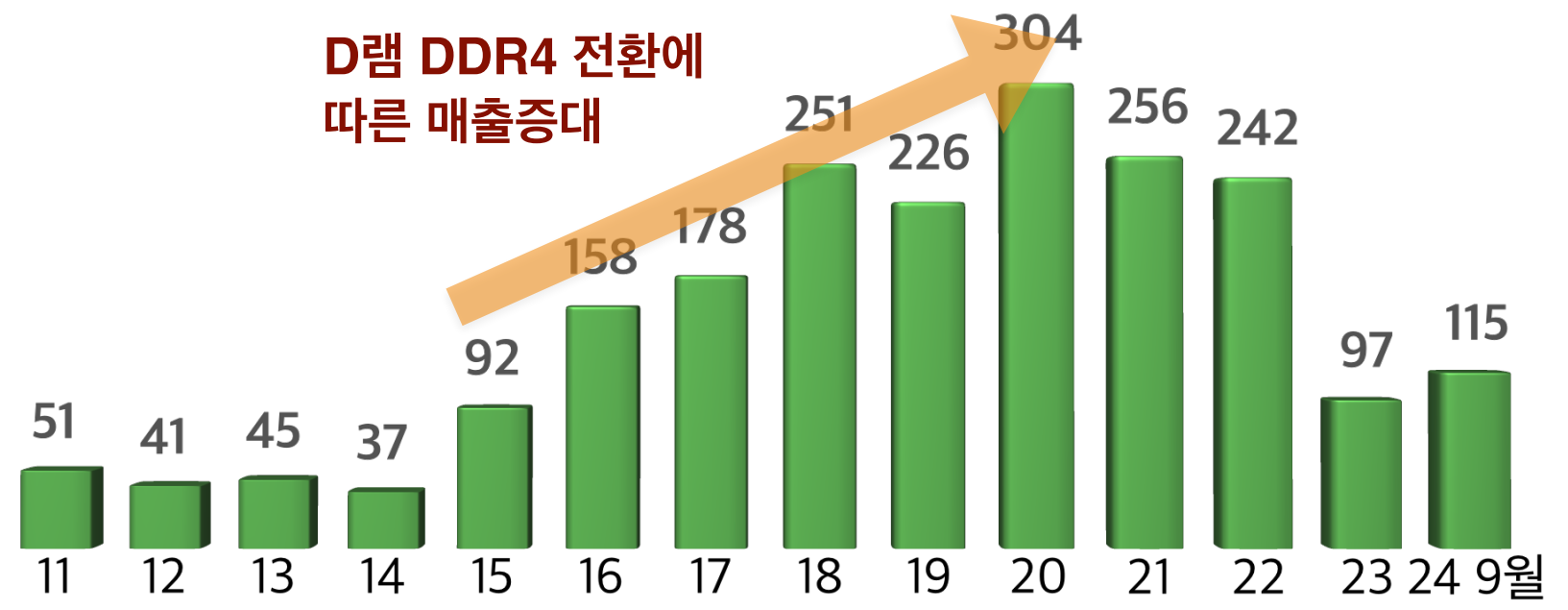
차세대 D-RAM DDR4 및 SSD, 칩저항기 공급 확대

- DDR2 및 DDR3에 적용되는 0402 size에서 DDR4에는 0201 size의 Chip Array Resistor 적용
- 현재 서버용, 모바일 DDR4 생산을 시작으로 최근 데스크탑 및 노트북용 DDR4 생산 확대
- DDR3에서 DDR4전환에 따른 Chip Array Resistor 교체 수요증가로 지속적인 매출 증가 및 성장

차세대 메모리 D-RAM DDR5 표준규격 개발, 상용화 예정

- 2017.06 JEDEC : 서버성능요구 사항이 증가함에 따라 고급기술이 증가, DDR5 표준화의 필요성 언급, 스펙 발표.
- 2020.07 JEDEC : DDR5 규격인 JESD79-5 고성능 DDR5 표준 발표
- DDR5 D-RAM 에 처음으로 인덕터 적용(DDR4 및 이전 세대에서는 인덕터 불필요)
- DDR5 에서의 메모리모듈의 전원관리 기술 변화 => PMIC(POWER MANAGEMENT IC, 전력관리반도체)는 마더보드가 아닌 메모리 모듈 자체에 탑재 예정 => DDR5 D-RAM 모듈에서의 수동소자(메탈파워인덕터 신규 적용 및 Chip Resistor) 채용 확대
- 온디바이스AI로 인해 신규 IT기기의 교체 수요와 메모리 탑재량 증가 전망
- 서버시장의 CPU 교체수요와 챗GPT 등 AI 기술 확산에 따라 중장기적으로 고성능 서버시장과 고용량 메모리 채용으로 수요 급증 예상.

반도체향 매출 추이 (단위: 억원)



[DDR4 Based-System]

[DDR5 Based-System]

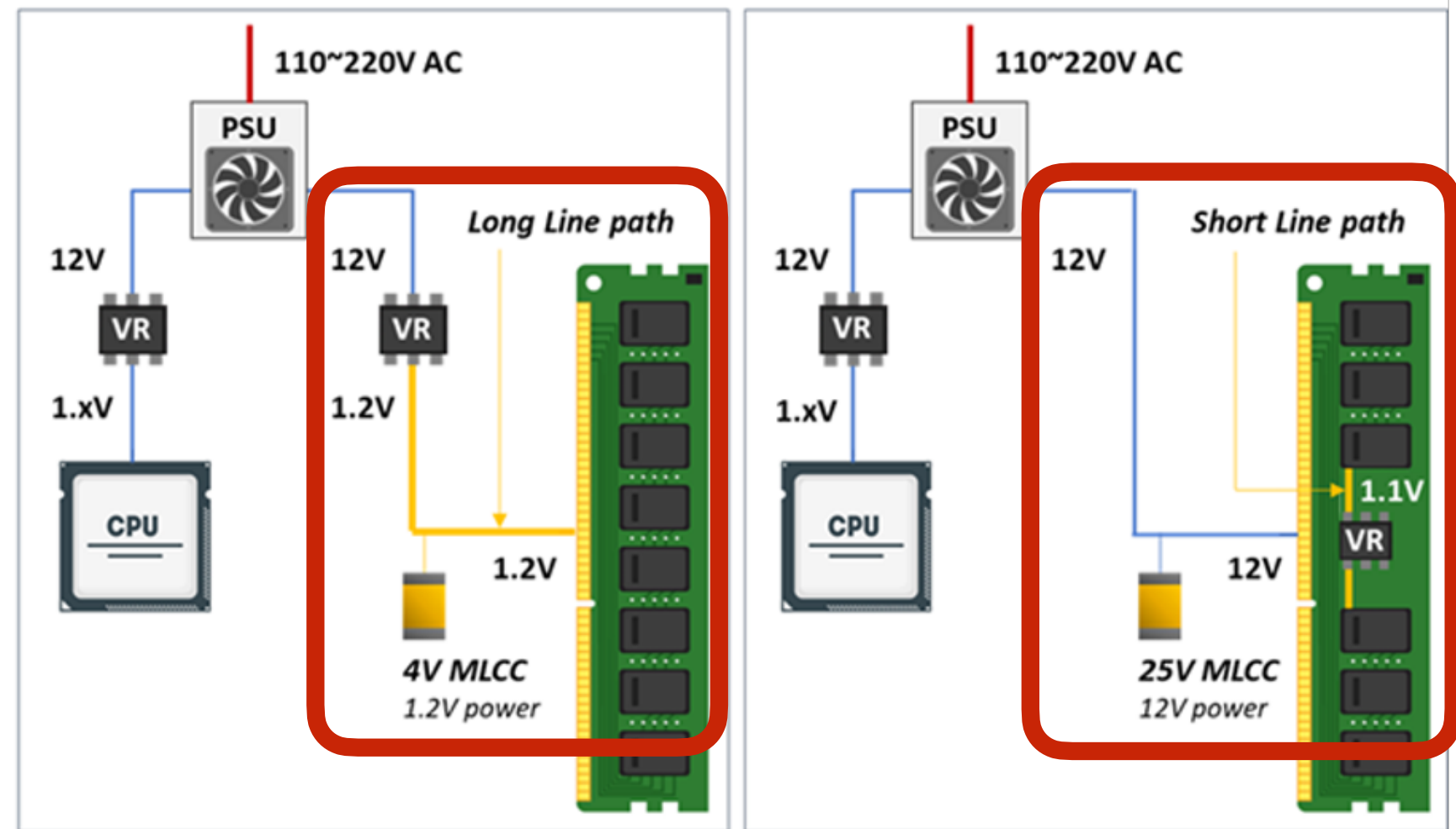


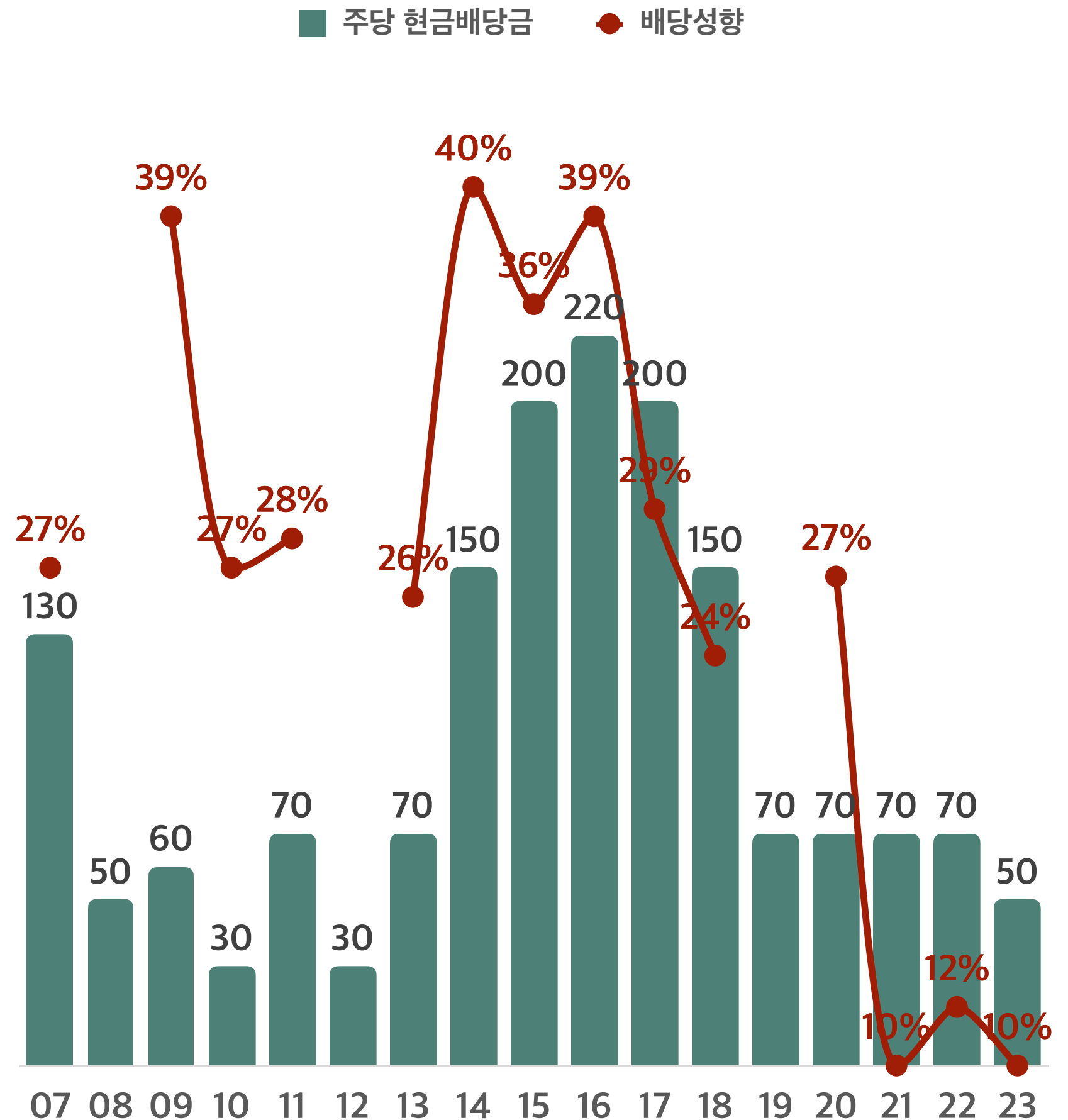
Figure2. DDR4 Based-system vs DDR5 Based-system

주주 친화적 정책 : 주주에 대한 이익 환원 - 현금배당

현금배당 추이 – 안정적인 실적, 배당성향 유지 및 확대

• 별도기준

구분	주당배당금	배당성향	시가배당률	영업이익	순이익
2023	50원	20%	0.34%	-22억원	33억원
2022	70원	12%	0.71%	85억원	80억원
2021	70원	10%	0.63%	65억원	89억원
2020	70원	27%	0.90%	74억원	35억원
2019	70원	-	1.37%	80억원	-23억원
2018	150원	24%	2.72%	88억원	84억원
2017	200원	29%	2.34%	95억원	92억원
2016	220원	39%	3.00%	111억원	71억원
2015	200원	36%	3.4%	85억원	72억원
2014	150원	40%	2.73%	67억원	44억원
2013	70원	26%	1.62%	45억원	32억원
2012	30원	-	0.7%	5억원	-39억원
2011	70원	28%	1.34%	45억원	27억원
2010	30원	27%	0.54%	40억원	13억원
2009	60원	39%	1.87%	24억원	17억원
2008	50원	-	2.76%	41억원	-23억원



요약 연결재무손익

과 목 (단위 : 백만원)	제52기 (2024년9월말)	제51기 (2023년말)	제50기 (2022년말)	제49기 (2021년말)	제48기 (2020년말)	제47기 (2019년말)	제46기 (2018년말)	제45기 (2017년말)	제 44 기 (2016년말)	제 43 기 (2015년말)	제 42 기 (2014년말)	제 41 기 (2013년말)
유동자산	80,894	75,532	85,684	96,716	84,319	79,990	76,096	66,956	67,437	61,025	47,951	42,510
현금및현금성자산	30,547	31,541	28,147	40,169	47,114	36,727	29,318	35,852	39,919	29,849	23,656	16,677
단기금융상품	14	-	1,235	385	979	240	-	8,171	8,171	8,171	8,171	8,171
당기손익-공정가치측정금융자산	13,219	6,111	11,314	11,765	2,092	9,825	7,887	-	-	-	-	-
매출채권 및 기타채권	16,996	15,985	18,396	17,639	14,402	15,711	17,330	12,655	10,720	12,716	10,970	11,034
기타유동자산	444	1,088	2,064	3,048	1,448	1,696	2,109	1,920	1,456	1,401	856	953
당기법인세자산	172	-	-	-	-	-	-	-	-	729	2	4
재고자산	19,483	20,787	24,529	23,710	18,283	15,792	19,453	8,358	6,659	8,204	5,910	6,229
매각예정비유동자산	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
비유동자산	66,415	69,533	61,766	44,977	37,670	40,912	49,202	26,017	26,629	28,904	37,786	44,167
당기손익-공정가치측정금융자산	1	-	1	1	1	494	3,426	-	-	-	-	-
장기금융상품	413	377	291	236	281	383	464	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190
장기매출채권 및 기타채권	137	131	88	100	109	276	372	975	916	962	970	2,199
관계기업투자	1,420	1,695	1,426	1,504	1,229	1,323	1,420	1,742	1,138	760	754	512
유형자산	59,107	60,587	54,321	40,565	33,189	35,219	40,975	18,769	22,703	24,464	30,566	34,927
무형자산	2,013	2,183	2,411	482	403	600	794	664	757	860	869	921
투자부동산	207	209	238	248	258	268	509	225	228	231	3,381	3,434
이연법인세자산	2,535	3,376	1,454	1,836	2,200	2,348	1,242	452	269	416	486	237
기타비유동자산	13	2	5	5	1	-	-	-	-	-	-	-
순확정급여자산	570	974	1,531	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자산총계	147,309	145,065	147,451	141,693	121,988	121,059	125,455	92,972	94,067	89,928	85,738	86,678
유동부채	21,795	20,421	25,753	29,428	13,987	9,132	7,535	4,718	9,420	12,753	22,655	24,151
단기차입금	5,000	5,000	2,000	2,000	2,020	2,020	0	0	22	2,956	12,972	16,645
비유동부채	13,609	11,369	4,708	6,814	8,135	9,496	7,877	60	1,225	2,327	1,710	6,214
부채총계	35,404	31,790	30,461	36,242	22,122	18,628	15,412	4,778	10,645	15,080	24,365	30,365
자본금	6,896	6,896	6,896	6,896	6,896	6,896	6,896	6,896	6,896	6,764	6,091	6,091
연결자본잉여금	31,329	31,329	31,329	31,329	31,420	31,420	31,420	31,449	31,449	30,318	24,459	24,459
기타자본구성요소	1,271	1,054	481	-	-	-	-	-	-	42	428	188
연결기타포괄손익누계액	78	(8)	1,178	1,186	222	702	563	558	523	513	194	103
연결이익잉여금	72,331	74,004	77,106	66,039	61,328	63,412	71,164	49,290	44,553	37,211	30,201	25,472
비지배주주 지분	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자본총계	111,905	113,275	116,990	105,451	99,866	102,430	110,043	88,193	83,421	74,848	61,373	56,313
매출액	91,660	125,030	164,697	147,677	124,120	123,322	99,846	84,083	80,607	68,372	57,033	59,802
영업이익	(3,538)	(4,712)	11,291	3,055	(1,905)	(2,321)	6,557	9,146	10,799	8,396	6,920	3,911
법인세비용차감전순이익	(357)	(4,345)	11,376	5,843	(1,004)	(1,434)	27,124	8,471	12,202	10,026	7,714	3,705
당기순이익	(1,008)	(2,373)	9,359	3,705	(2,673)	(5,058)	26,153	7,664	10,020	8,811	5,643	3,375
총포괄손익	(923)	(4,379)	11,989	6,607	(1,634)	(5,619)	24,537	7,697	9,957	8,912	5,637	3,377
기본주당순이익(원)	(76)	(179)	704	279	(201)	(381)	1,967	577	764	702	483	292
희석주당순이익(원)	(76)	(179)	704	279	(201)	(381)	1,967	577	764	699	477	289

감사합니다.
